

氮化硅基板是一种综合性能优异的陶瓷基板,伴随着第三代半导体逐步取代传统硅基半导体,电力电子器件向高电压、大电流、小尺寸和高输出功率方向快速发展,氮化硅陶瓷基板逐渐成为高频电路、功率器件模块散热和封装用首选材料。

一般特点 General Characteristics

化学成分:氮化硅

微观形貌:晶粒尺寸均匀

外观:深灰色



技术特性 Technical Characteristics

- 超大规格
- 高导热率
- 高机械强度
- 优良的平整度

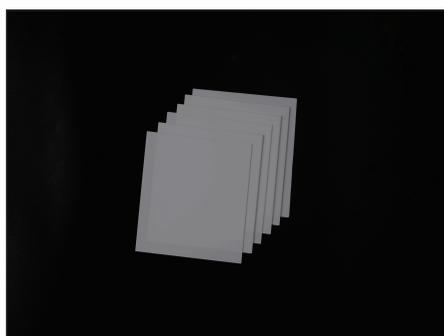
技术指标 Technical Properties

技术指标	典型值	测量标准
体积密度 g/cm ³	≥3.2	GB/T 25995-2010
热导率 W/(m·K)(25°C)	>90	GB/T39862-2021
抗弯强度 MPa	≥680	GB/T6569-2006
介电常数 (1MHz)	7-9	GB/T 5594.4-2015
击穿电压 (kV/mm)	>20	GB/T 1408.1-2016
体积电阻率 Ω·cm(25°C)	>10 ¹⁴	GB/T31838.2-2019
介电损耗 10 ⁻⁴ (@1MHz)	≤3	GB/T 5594.4-2015

产品规格表

	规格	厚度											Ra		
		0.2	0.25	0.32	0.38	0.5	0.635	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	0.4-0.8	0.1-0.4	0.02-0.1
方形	400*400						○	○	○	○	○	○	○		
	400*350						○	○	○	○	○	○	○		
	350*300						○	○	○	○	○	○	○		
	300*250						○	○	○	○	○	○	○		
	250*200						○	○	○	○	○	○	○		
	200*200				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	190*138			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	160*160		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	120*120		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	100*100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50*50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
圆形	D400						○	○	○	○	○	○	○		
	D350						○	○	○	○	○	○	○		
	D300						○	○	○	○	○	○	○		
	D250					○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	D200				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	D150		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	D100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	D50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

说明: 非标尺寸需要定制, 请咨询公司销售人员。



广州英诺创科先进材料科技有限公司

地址: 广州黄埔区永丰路2号B栋201房

电话: 189-2895-1632